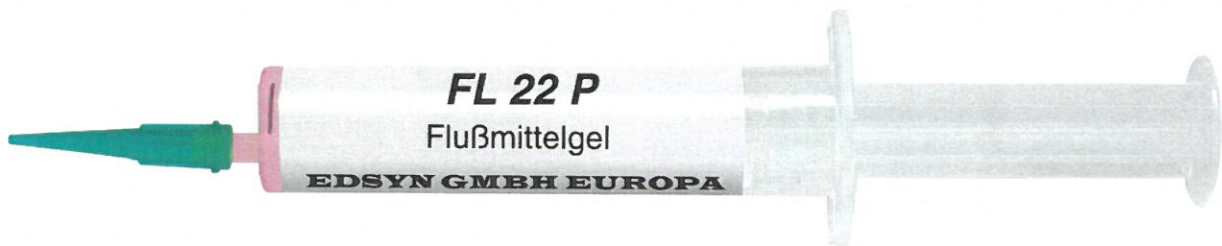




FL 22 P POWER Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
auch bei schwierigen Oberflächen möglich

soldering of SMD and fine pitch components
also at difficult surface as easy as pie



Vorteile:

- * *das Löten von schwierigen Komponenten wird mit einer relativ milden Aktivierung ermöglicht*
- * leichte Handhabung
- * leichte Dosierspritze
- * hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen
- * einwandfreie Lötresultate beim Einsatz mit Heißluft- und LötKolben, auch mit MINI - FLOW - Lötspitzen
- * schnelle Reparaturen werden möglich
- * Flußmittelgel kann sich nicht so schnell wie Flußmittel auf Alkoholbasis verflüchtigen
- * Aktivierung von massiv verschmutzten Pads und Bauteilbeinchen

Advantages:

- * *the soldering of difficult components will be possible with a nearly mild activation*
- * easy handling
- * light weight proportion syringe
- * ideal for fine pitch and SMD applications
- * perfect soldering results with hot air tools and soldering irons; excellently suited for MINI FLOW soldering tips
- * enables quick repair
- * lower volatility than alcohol-based fluxes
- * activation of extreme dirty pads and component legs

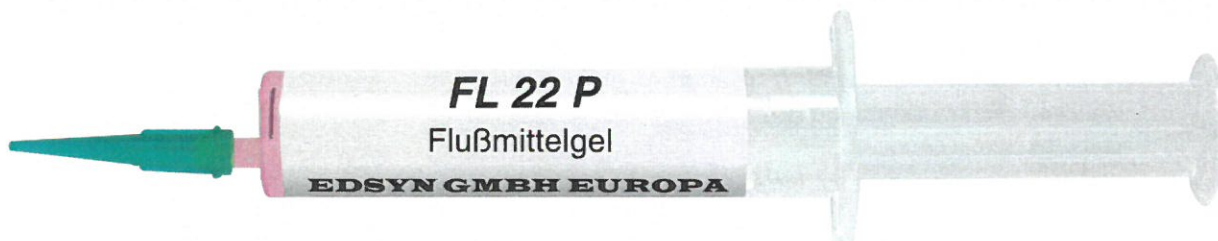




FL 22 P POWER Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
auch bei schwierigen Oberflächen möglich

soldering of SMD and fine pitch components
also at difficult surface as easy as pie



Mit dem Flußmittelgel **FL 22 P** wird über eine konische Dosierspitze, Flußmittel gezielt und sparsam auf SMD-Pads oder zu lötende Flächen aufgetragen. Anschließend können herkömmliche Lötstellen leicht und einfach gelötet werden.

SMD-IC's nach dem Positionieren an den Beinchen leicht mit Flußmittelgel benetzen. Danach wird mit einem LONER SMD Lötgerät und der EDSYN - MINI FLOW - Lötspitze Lot an den Pads und Beinchen aufgetragen. Kinderleicht gelingt das Anlöten von schwierigsten Bauteilen.

Gerade bei oxidierten oder verschmutzten Komponenten ist es schwierig ordentliche Ergebnisse beim Löten zu erhalten. Daher kann ein kraftvoller Aktivator hier von nutzen sein.

Bei diffizilen Komponenten empfehlen wir hier einen Waschvorgang.

Die Flußmittelzusammensetzung entspricht **F-SW 26 (DIN 29 454 / 1.2.2.C - DIN 8511)**.

Inhalt: 5 ml

Flußmitteltyp: DIN EN 29454 / 1.2.2.C
F-SW 26 RE LO

Vorsicht:

- * von Zündquellen fernzuhalten
- * nicht rauchen
- * Behälter dicht geschlossen halten
- * Zündpunkt: **420°C**

The conical proportioning tip of **FL 22 P** allows controlled and sparing application of flux to SMD pads or any surfaces to be soldered. You can then easily solder regular joints.

First, flux is sparingly applied to the legs of properly positioned SMD ICs. Then solder is applied to pads and legs using a LONER SMD soldering tool fitted with an EDSYN MINI FLOW tip. Now even the most demanding soldering applications are no longer a problem.

Flux residues, which hardly occur when **FL 22 P** is carefully applied, usually do not affect the soldering joint.

Practise has shown that using this flux with its low solids content usually eliminates the need for washing the soldered circuit board.

The composition of this flux complies with **F-SW 26 (DIN 29 454/1.2.2.C - DIN 8511)**

Content: 5 ml

Flux type: DIN EN 29454 /1.2.2.C
F-SW 26 RE LO

Precautions:

- * keep away from ignition sources
- * do not smoke
- * keep container tightly closed
- * ignition point: **420 °C**